Imballaggio & Consegna
dettagli sul confezionamento
Confezione al dettaglio: bottiglia
Tempo di consegna
3 ~ 5 giorni, l'ora esatta dipende dalla quantità
MIGLIORE 705 Lega di piombo senza piombo, argento piombo senza piombo

Descrizione del prodotto
La migliore pasta saldante (stagno) è la scelta migliore per il reballing IC.
MIGLIORE marca originale,
Qualità verificata

Applicazione: può essere utilizzato per computer portatili / computer / telefoni cellulari / elettrodomestici SMD IC e riparazione BGA IC, strumenti per la riparazione di chip-level e linea di produzione di elettronica.

Parametro tecnologico
Modello
BEST-705
Composizione della lega:
Stagno: 99% / argento: 0,3% / rame: 0,7%
Punto di fusione :
226-229 ° C
Dimensione delle particelle di polvere di stagno:
25-45 / micron
Forme di polvere di latta:
sferico
Contenuto di metallo:
89,5 ± 1%
Temperatura di refrigerazione:
5 ~ 10 ° C
N.W .:
50g / pc

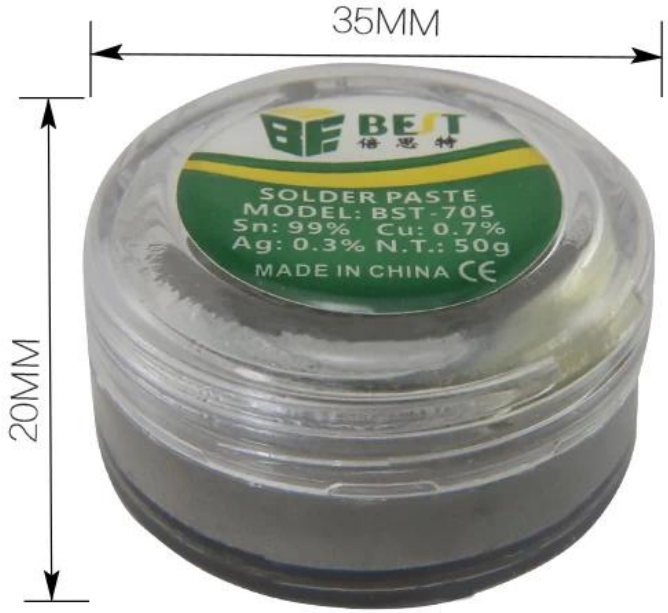
Cosa possiamo fornirti?
Questo prodotto è prodotto per la riparazione di telefoni cellulari di cui 9 tipi diversi.
Puoi acquistarli separatamente, oppure puoi acquistarli 5 pezzi per set. Puoi combinare questi 9 tipi per un set per il tuo ordine.

Perché sceglierci?
1. Con 16 anni di esperienza in questo campo, abbiamo la capacità di fornire un buon servizio e prodotti a basso costo
2. L'inventario adeguato assicura una fornitura sufficiente di prodotti ai nostri clienti in un breve periodo.

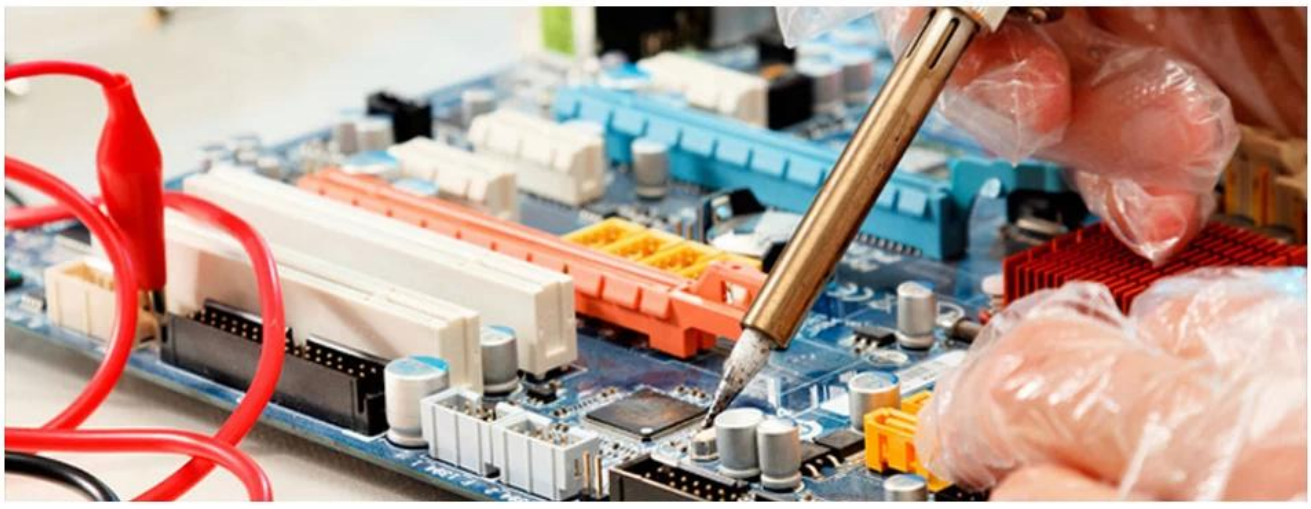
Spettacolo del prodotto

PRODUCT DISPLAY

PRODUCT DETAILS



Name: Solder paste	Model: BST-705
Size: Φ35*20mm	Weight: 40g
Composition: SN99/AG0.3/CUO.7	Melting point: 226℃~229℃



Storage:Chilled in refrigerator,the best refrigeration temperature is 5℃~10℃.

Features: 1. When continuous printing, its viscosity changes less, which can obtain very stable printing.

2. The circuit with the spacing of 0.4-0.6mm and above can complete fine printing.
3. With excellent weld ability, it can show proper viscosity in different parts.
4. It is suitable for the return welding furnace of general atmosphere and nitrogen.
5. Good weldability can be obtained at extremely high peak temperature.

PRODUCT PHOTOGRAPH

BEST
SOLDER PASTE
MODEL: BST-705
Sn: 99% Cu: 0.7%
Ag: 0.3% N.T.: 50g
MADE IN CHINA

BEST
SOLDER PASTE
MODEL: BST-705
Sn: 99% Cu: 0.7%
Ag: 0.3% N.T.: 50g
MADE IN CHINA

BEST
环保•无铅